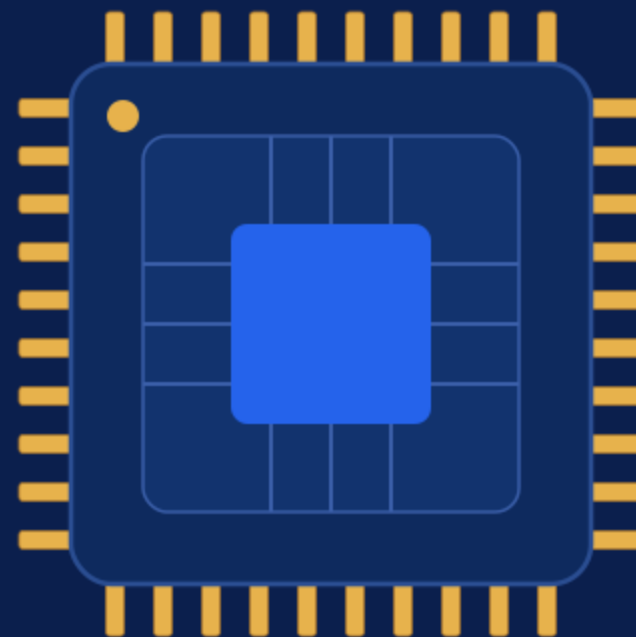


週間 米国半導体ニュース

# メモリ争奪が自動車へ、 脱HBMの挑戦者

AIメモリ不足がGMを動かし、QualcommはHBM無しで挑む。一方、半導体は急反落した1週間



📅 2026年6月28日～7月4日

## 今週の要点：メモリ不足が自動車へ波及、そして過熱相場の巻き戻し

1

**+450%**

DRAM現物価格  
(25年9月→26年1月)

2

**Micron × GM**

長期メモリ供給契約  
(7/1 締結)

3

**6倍**

Qualcomm HBC  
バンド幅/ワット(HBM比)

4

**-12.9%**

SOXX 2営業日下落  
(25年3月以来最大)

5

**-13%**

NVDA 直近30日  
(TSMCは+4.5%)

AIメモリ不足は自動車にまで波及。脱HBMの挑戦者も現れるなか、過熱した相場は急反落した。

## Micron×GM：AIメモリ不足、ついに自動車を動かす（7/1）

**+450%**

DRAM現物価格の上昇（2025年9月→2026年1月）

STRATEGIC DEAL

100%

2025年9月

550%

2026年1月

- 1 GMの次世代車へ長期メモリ供給（LPDRAM／NOR／UFS NAND）。ADASと車内AI体験向け。
- 2 Manassas（バージニア州）工場の\$20億投資が下支え、今年から量産。
- 3 Micronが結んだ16の戦略的顧客契約の1つ。AI不足で自動車OEMも数年先の容量を確保。
- 4 背景に決算の過去最大級の好調と、記録的なメモリ需要。

## メモリ争奪の連鎖：データセンターから自動車・PCへ

### 1 データセンター

HBM完売。AIサーバがDRAM/NANDを大量消費。

### 2 自動車

Micron×GM等、OEMが長期契約で容量を確保。

### 3 価格

DRAM現物価格が数ヶ月で約+450%。全用途に波及。

需要の源泉：AIデータセンター（HBM/DRAM） + ソフトウェア定義車（SDV）

メモリ不足はもはやAIだけの話ではない。電機も自動車も、数年先の供給を奪い合っている。

## 脱HBMの挑戦者：QualcommがNVIDIAの牙城に迫る

# 6倍

HBC（近メモリ演算）のバンド幅/ワット（HBM比）

DRAMの下に演算を積層し「メモリの壁」を破る設計。  
AI250は133TB/s/カード。Meta・Microsoftが発注。

- 1 Dragonflyポートフォリオ：C1000 CPU、HBC、AI300推論アクセラレータ、AI200/AI250。
- 2 HBM無しでコスト・電力効率を訴求し、AI推論に特化。
- 3 QualcommはAIアクセラレータ市場を2029年度に\$680Bと予測。

## AIチップの構図：NVIDIA一強に挑む3つの動き

### Qualcomm

HBC/脱HBMで推論に特化。Meta・Microsoftが採用。

### カスタムASIC

ハイパースケラーの自社設計が拡大  
(AWS/Google/Meta)

### AMD

MI400/MI450でOpenAIが大規模採用（前週報）。

NVIDIAの牙城は依然強大。だが「HBM前提」「GPU前提」を崩す動きが同時多発的に出てきた。

## 相場：史上最強の上半期から一転、急反落

### SOXX

2025年3月以来最大の2日下落。ただし年初来はなお+82%。

2日で-12.9%

### Micron

年初来は+260%超と依然堅調。

一時-10%超

### Great Rotation

利益確定の資金が『地味な』大型株へ回る。

テック→ダウ

上半期に+80%超の反動。熱狂の巻き戻しが始まった。

## 分岐：ロジックの巨人が調整、製造の要は底堅い

**-13%**

NVDA 直近30日。同じ期間にTSMCは+4.5%と逆行した。

NVIDIA -13%



TSMC +4.5%

- 1 AIの主役NVIDIAに利益確定売り。短期は過熱の反動が優勢。
- 2 一方、全社が頼るファウンドリTSMCは底堅い（FY26 +30%超、HPCが売上の61%、対米\$20B投資）。
- 3 「誰が供給を握るか」への資金シフトが続く。

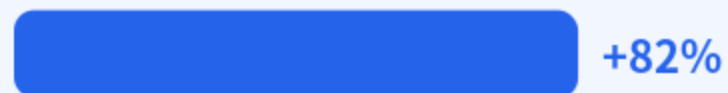
## それでも上半期は歴史的な強さ

2026年 年初来リターン(%)

S&P500



SOXX (半導体ETF)



≈ 8× の差

- 1 半導体ETF SOXXは急落後も年初来+82%（6月ピークは+115%）。
- 2 メモリとAIインフラが牽引。上半期はセクター有数の強さ。
- 3 ただ短期は、過熱の反動とローテーションに注意。

## 日本のステークホルダーへ：3つの戦略的示唆

1

### メモリ超循環に備える

DRAM/NAND値上げと長期契約化。日本の材料・車載半導体に商機。

2

### 脱HBM・脱GPUの潮流を注視

Qualcomm HBCなど新アーキが、供給計画の前提を変え得る。

3

### 相場の過熱と巻き戻しを管理

上半期+80%超の反動。ボラティリティを前提に計画する。

## 出典 & 参照 (2026年6月28日～7月4日)

### 決算・市場

Benzinga / Yahoo Finance / CNBC / intellectia

### 企業・製造

GlobeNewswire / Reuters / Tom's Hardware / HPCwire / DCD

### メモリ・自動車

evertiq / interestingengineering / TrendForce

### AIチップ動向

SiliconANGLE / VideoCardz

公開情報を自律的に統合。数値は各社発表・報道時点。※投資助言ではありません。